



週間半導体ニュース

2026年9月7日～9月13日

High NA EUVの長期ロードマップが具体化し、メモリ制約への挑戦に大型資金が集まり、州がAI規制で先行した一週間。

Miki Matsui, Co-Founder, CHIP-J

出典：ASML・NVIDIA・Apple・NIST／米商務省・カリフォルニア州知事室・Lyft・PR Newswire
・CNBC・TechCrunch

今週の注目

2033年

ASMLとTSMC、 12インチマスク へ

High NA EUV向けに12インチフォトマスクへ移行する業界イニシアチブを発足。2031年にパイロットライン、2033年に量産対応を目指す。 ([ASML発表、9/8](#))

8.75億ドル

Positron AI、評 価額50億ドルで 調達

HBMではなく汎用LPDDR5Xを搭載する推論チップAsimovを開発。TSMC N3Pで2026年末テープアウト、2027年後半に量産。 ([PR Newswire、9/10](#))

全米初

カリフォルニア 州、AI監査基準 を導入

ニューサム知事がSB 813とAB 1405に署名。独立検証組織の枠組みとAI監査人の登録制度を定める、全米初の州基準となる。 ([州知事室、9/9](#))

1. AIチップ・GPU

- **Huang、来期70%成長に自信を表明**

ゴールドマン・サックスのカンファレンスで、来期の売上高70%成長に自信を示した。制約がなければ需要の伸びは100%超とする一方、供給網・用地・電力の制約も認めた。正式なガイダンスではなくCEOの見解である点には留意が必要。 ([TechCrunch、9/10](#))

- **d-Matrix、NVLink Fusionを採用**

推論チップメーカーd-Matrixが、次世代Raptor XPUをNVLink FusionでNVIDIAの基盤に接続すると発表した。競合アーキテクチャがNVIDIAのスケールアップ網を利用する形となり、独自ファブリック開発の負担を回避する。 ([NVIDIA発表、9/10](#))

- **NVIDIAとPalantir、ソブリンAIで提携**

重要サプライチェーン向けのソブリンAIで協業し、NVIDIA自身の業務を第1号案件とすると発表。データとモデルの国内管理を求める市場に対し、計算基盤とデータ基盤を組み合わせで提供する構図となる。 ([NVIDIA発表、9/10](#))

- **Skild AI、動画1本で学習するS1を公開**

NVIDIAのフィジカルAI基盤上で動くロボット基盤モデルS1を発表した。製造現場で1本のデモ動画から新しい作業を習得でき、個別の再プログラミングを不要にする。エッジ推論シリコンの新たな需要源となる。 ([NVIDIA発表、9/10](#))

2. 前工程とサプライチェーン

- **ASMLとTSMC、12インチマスク移行を主導**

SPIE BACUS会議を前に、6インチから12インチフォトマスクへ移行する業界イニシアチブを9月7日に発足。2031年にパイロットライン、2033年に量産対応を目標とする。TSMCはHigh NAを2030年から先端ノードの量産に使う意向を明示した。 ([ASML発表、9/8](#))

- **TSMCとSamsungがHigh NA EUVを採用**

両社がASMLのHigh NA EUVの採用を表明し、Intelに続く顧客となった。SamsungはDRAM向けに2028年の適用を目指す。High NAは当面は現行の6インチマスクで運用され、12インチ化はその後の生産性向上策と位置づけられる。 ([CNBC、9/8](#))

3. コンシューマー向けチップ

- **Apple、2nmのA20 ProをiPhone Duoに搭載**

初の折りたたみiPhone Duoを256GB版1,999ドルで発表。A20 Proは2nm製造で、6コアCPUがA19 Pro比で最大20%高速、7コアGPUは最大40%高速、新しいDual 16コアNeural Engineは演算性能2倍、メモリ帯域は50%増。予約は10月16日、発売は10月23日。 ([Apple発表、9/9](#))

- **民生用メモリ価格は高値圏が継続**

AI向けにHBMへラインが振り向けられた結果、汎用DRAMとNANDの逼迫が続き、DDR5・DDR4の店頭価格は8月に付けた高値圏のまま9月に入った。PC・スマートフォン各社はAIインフラと同じ供給プールを奪い合う構図にある。 ([Tom's Hardware価格指数、9/7週](#))

● 4. データセンターと電力

● NVIDIA、豪州で土地・電力・シェ尔容量を確保

豪州のNVIDIA Cloud Partnersなどと連携し、複数世代のNVIDIA DSXを収容できる土地・電力・シェ尔容量を確保すると発表した。単一案件ではなく土地と電力を軸に押さえる構造で、米国で顕在化した用地・系統制約へのヘッジとなる。 ([NVIDIA発表、9/9](#))

● OpenAI、Astra需要で新規Pro契約を一時停止

Astraの需要が提供可能な計算資源を上回ったとして、Pro階層の新規登録を停止した。需要ではなく推論供給が制約になっていることを公に認めた稀な例であり、GPUとメモリの逼迫が消費者向け製品の提供可否にまで及び始めている。 ([TechCrunch、9/10](#))

5. 自動運転・車載チップ

● WaymoがLyftアプリで運行開始（ナッシュビル）

Lyftアプリから直接Waymo車両を配車できる初の都市となった。子会社Flexdriveが車両準備・充電・清掃・整備を担い、約7,400平方メートルの専用デポを10月に開設、70人超の常勤職を新設する。 ([Lyft発表、9/9](#))

● ロボタクシー各社がNVIDIA基盤に集約

NVIDIAは、商用規模で稼働する主要ロボタクシー計画がいずれも同社の三層構成（学習・シミュレーション・車載）で動いていると説明。ゴールドマン・サックスの予測を引用し、市場規模は2035年に4,000億ドル、商用車両600万台超に達するとした。 ([NVIDIA発表、9/10](#))

● Tesla、第2世代Roadsterを10月1日公開

長く遅延していた第2世代Roadsterの発表日を10月1日に設定した。Cybercabの展開が連邦当局の調査対象となるなか、dated milestoneを一つ追加した形となる。TeslaのAV計画は自社製推論シリコンへの依存を一段と深める。 ([TechCrunch、9/12](#))

6. チップスタートアップ・投資

8.75億ドル

Positron AI（評価額50億ドル）

3.75億ドルのシリーズC（プレ35億ドル、NEA等が共同主導）と、NEAとJim Clarkが主導する最大5億ドルのC-1の2段構成。Asimovは1チップに288GB～2,304GBのLPDDR5Xを搭載し、HBMとCoWoSへの依存を回避する。 ([PR Newswire、9/10](#))

4.68億ドル

Kepler Computing（ステルス脱却）

7年のステルスを経て強誘電体3D積層メモリを公開。累計調達額は4.68億ドルで、GlobalFoundries（5,000万ドル）、Intel Capital、AMD Ventures、Baillie Gifford、Gates Frontierが出資。CHIPS法のLOIは最大2.45億ドル。 ([Hoodline、9/9](#))

IPO準備

Nscale、Fidji Simo氏を取締役に迎える

ロンドン拠点のAIデータセンター事業者が、OpenAIでAGI Deployment担当CEOを務めたFidji Simo氏を取締役に招聘した。同氏はInstacartのCEO兼会長として2023年の上場を主導した経歴を持つ。秋の上場を視野に入れた布陣となる。 ([PR Newswire、9/11](#))

30億ドル

The Boring Company、UAE主導で調達

Elon Musk氏のトンネル掘削会社がUAE勢主導で30億ドルを調達した。湾岸資金が米国のハードウェア案件でリード投資家の座に就く流れを示し、AIデータセンターやチップ案件を支える資金プールと重なる。 ([TechCrunch、9/10](#))

7. CHIPS法R&D、量子4社に確定

米商務省が9月8日、量子4社とのCHIPS法R&D最終契約に署名。いずれも上限1億ドル（最大計4億ドル）で、量子予算を半導体プロセス基盤に流す設計となっている。

PsiQuantum

光子量子計算の技術課題に対応し、成熟・高性能な電気光学材料、高温動作の単一光子検出器、超低損失な光パッケージングを半導体製造に統合する。 ([NIST、9/8](#))

D-Wave

アニーリング方式およびゲート方式の超伝導量子計算システム向けに、半導体プロセス技術の重要な高度化を進める。 ([NIST、9/8](#))

Quantinuum

誤り耐性を備えたイオントラップ型量子計算機のスケーリングに向け、量子半導体製造上のボトルネックに取り組む。 ([NIST、9/8](#))

Rigetti

次世代の超伝導量子計算技術の開発と規模拡大に向け、読み出し回路、クライオスタット構造、高接続チップ向けの製造能力に取り組む。 ([NIST、9/8](#))

8. カリフォルニア州のAI規制

期間中に新たな232条関税措置はなし。一方カリフォルニア州は、AI規制で全米初の措置に踏み切った。

第三者監査・独立評価で全米初の州基準

ニューサム知事がSB 813とAB 1405に署名。前者はAIシステムの適合性を評価する独立検証組織の枠組みを、後者はAI監査人の州登録制度と独立性・透明性の基準を定める。監査を一律に義務づけるものではなく、第三者評価の土台を整える立法である。 (州知事室、9/9)

児童保護：対話型AIとSNSを超党派で規制

翌10日には、コンパニオン型チャットボットに対する全米最強とされる安全規制と、未成年向けSNSの中毒性機能の禁止を含む法案に署名した。超党派で成立し、事業者にはAIとの対話における未成年保護の実装が求められる。 (州知事室、9/10)

行政サービス案内ツール「AskCA」を公開

3月のAI大統領令に基づき、州民が行政サービスにたどり着きやすくするAI案内ツールAskCAを公開した。規制と同時に州自身がAIの調達・運用主体となる姿勢を示す。なお半導体製造や工場立地に関する発表は期間中なかった。 (州知事室、9/9)

日本への示唆

今週の確認済みニュースに紐づく、日本の各セクターへの含意。

材料メーカー

12インチマスク移行が最大の論点

6→12インチの移行は、信越化学やHOYAが担うブランク基板・レジスト・ペリクルの再認定を伴う。パイロットラインは2031年で時間はあるが、規格策定に早期参加した企業が有利になる。(ASMI 9/8)

ファウンドリ

TSMCのHigh NAは2030年から

TSMCがHigh NAの量産適用を2030年と明示したことは、後発のRapidusにとって先端露光で一世代遅れが確定しないことを意味する。2nm GAAの立ち上げに集中できる時間的余地がある。(ASML 9/8)

装置メーカー

新マスク形式が描画・検査を刷新

12インチマスクは描画・検査・計測装置の刷新を伴い、レーザーテックや東京エレクトロンに新規需要をもたらす。2033年の量産対応という長期の設備サイクルが視野に入る。(ASMI 9/8)

政府

量子予算を半導体基盤に流す米国の型

商務省が量子3社への支援を光パッケージングや超伝導プロセスなど半導体製造の課題として設計した点は、METIの量子・先端パッケージ政策が参照しうる明確な型となる。(NIST 9/8)



出典と検証方針

- ASML（9/8プレスリリース） — 12インチマスク移行、TSMCのHigh NA 2030年量産
- NVIDIA Newsroom / Blogs（4本） — d-Matrix、Palantir、Skild AI、豪州データセンター、ロボタクシー
- Apple Newsroom（9/9） — iPhone Duo、A20 Proの仕様と価格
- NIST／米商務省（3本、9/8） — CHIPS法R&D最終契約（PsiQuantum・D-Wave・Quantinuum）
- カリフォルニア州知事室（3本、9/9～9/10） — AI監査義務化、児童保護法、AskCA
- PR Newswire（Positron AI 9/10、Nscale 9/11） ・ Lyft IR（9/9） ・ CNBC ・ TechCrunch ・ Tom's Hardware

全項目を一次資料または名指しの報道機関で照合。期間外・出所不明・観測記事のみの項目は本資料から除外しています。

Miki Matsui, Co-Founder, CHIP-J